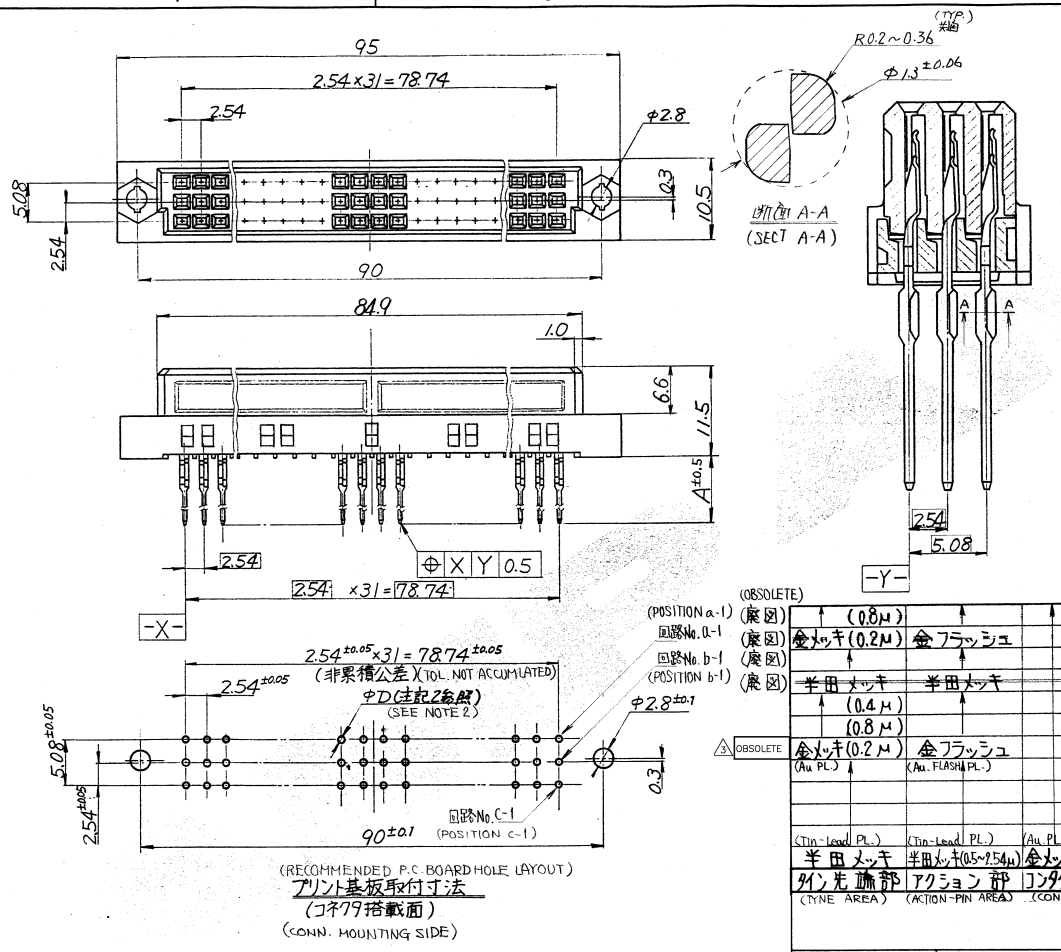

(RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE LAYOUT)

プリント基板取付寸法

(コネクタ搭載面)

(CONN. MOUNTING SIDE)

注記

1. 材料：コンタクト… 銅合金
   ハウジング… 熱可塑性ポリエステル樹脂
   (灰色)
2. アクションピンの適合基板仕様
   材質：NEMA等級G10 ガラスファイバー入りエポキシ
   又は相当品
   厚さ：1.6mm～3.2mm
   スルホール径(φD)
   下穴径 ：1.15 +0.025
   銅層厚さ ：0.025～0.075 (硬度：ISO規定最大)
   錫鉛層の厚さ ：0.004～0.010
   メッキ後の穴径 ：0.94～1.09
   錫鉛リフロー後の仕上穴径 ：0.91～1.09

NOTE

1. MATERIAL : CONT. ···· COPPER ALLOY
   HSG. ···· POLYESTER (GRAY)
2. P.C. BOAPD SPEC. FOR ACTION-PIN.
   MATERIAL : GLASS-FIBER EPOXYDE
   (i.e. NEMA GRADE G10)
   BOARD THICKNESS ; 1.6～3.2mm
   PLATED-THROUGH HOLE SPEC (φD)
   HOLEDIA AFTER DRILLING : 1.15±0.025
   Cu LAYER : 0.025～0.075
   Sn/Pb LAYER : 0.004～0.010
   HOLE DIA AFTER PLATING : 0.94～1.09
   FINISHED HOLE DIA AFTER Sn/Pb REFLOW : 0.91～1.09

(OBSOLETE)	(TYNE AREA) タイン先端部	(ACTION-PIN AREA) アクション部	(CONTACT AREA) コンタクト接触部	(UNDER PL.) 下地メッキ	(DIMENSION "A") 寸法 "A"	型番(P/N)
	(0.8μ)		(0.8μ)			2- -4
廃図	金メッキ(0.2μ)	金フラッシュ	(0.2μ)			2- -3
廃図			(0.8μ)			2- -2
廃図	半田メッキ	半田メッキ	(0.2μ)		21	2- -1
	(0.4μ)		(0.4μ)			1- -5
	(0.8μ)		(0.8μ)			1- -4
3 OBSOLETE	金メッキ(0.2μ) (Au PL.)	金フラッシュ (Au. FLASH PL.)	(0.2μ)			1- -3
			(0.8μ)			1- -2
			(0.2μ)		16.2	1- -1
			(0.4μ)			-4
	(Tin-Lead PL.)	(Tin-Lead PL.)	(Au PL.) (0.8μ)	(Ni PL.)		-2
	半田メッキ	半田メッキ(0.5~7.54μ)	金メッキ(0.2μ)	ニッケルメッキ	4.7	174107-1

TE Connectivity

C2	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	28MAR11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

抱合電線断面積(WIRE RANGE) mm²(AWG)	被覆外径 (INSULATION DIA.) mm	名称 (NAME) IEC タイプ"C" フィメールコネクタ(96極) (IEC CONN. TYPE "C" FEMALE ASSY 96 Pos.)	
材料 (MATERIAL) (SEE NOTE) 注記参照	仕上 (FINISH) (SEE NOTE) 注記参照	一般公差	SIZE B / LOC J / 番号 (NO.) C-174107
DR. T.YONEBAYASHI 11/9/87	DE. 11/9/87		
CHK. Y.Fujimura 11/9/87	APP. 11/9/87		尺度 (SCALE) NTS / REV. C2 / SHEET 1 of 1

△3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

PRINT DIST

仕様：対応 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

Downloaded from Elcodis.com electronic components distributor